

Title (en)

Nickel or cobalt chemical plating bath using reducing agents containing boron or phosphor.

Title (de)

Bad zum chemischen Abscheiden von Nickel- oder Kobaltüberzügen unter Verwendung eines Reduktionmittels auf der Basis von Bor oder Phosphor.

Title (fr)

Bain pour le dépôt chimique de nickel et/ou de cobalt utilisant un réducteur à base de bore ou de phosphore.

Publication

EP 0102874 A1 19840314 (FR)

Application

EP 83401550 A 19830727

Priority

FR 8213431 A 19820730

Abstract (en)

[origin: US4486233A] A nickel and/or cobalt chemical plating bath comprises: a salt of the metal(s) to be deposited; one or more complexing agents of said metal(s), a reducing agent based on boron or phosphorous; and a stabilizing agent. To avoid including sources of corrosion and/or toxic substances in the plating, the stabilizing agent comprises a water soluble organic compound which possesses a readily accessible electron pair, and which does not include any metal or metalloid from group IIIa (other than boron or aluminum), IVa (other than carbon), Va (other than nitrogen or phosphorous), VIa (other than oxygen), or VIIa (other than fluorine or chlorine).

Abstract (fr)

L'invention concerne un bain pour dépôt chimique de nickel et/ou de cobalt, comprenant un sel du métal (ou des métaux) à déposer un ou plusieurs complexants de ce métal (ou de ces métaux), un réducteur à base de bore ou de phosphore et un stabilisant. Selon l'invention, le stabilisant est un composé soluble dans l'eau ne comprenant ni soufre ni métal lourd et possédant un doublet électronique facilement accessible, de préférence choisi parmi les hétérocycles à caractère aromatique comprenant un ou plusieurs hétéroatoms d'azote et/ou d'oxygène. De tels bains peuvent être utilisés pour le revêtement de pièces travaillant à haute température et dans l'industrie alimentaire.

IPC 1-7

C23C 3/02

IPC 8 full level

C23C 18/34 (2006.01)

CPC (source: EP US)

C23C 18/34 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

[AD] FR 2329762 A1 19770527 - SHIPLEY CO [US]

Cited by

EP2339050A1; KR100930879B1; EP1306465A3

Designated contracting state (EPC)

DE GB IT

DOCDB simple family (publication)

FR 2531103 A1 19840203; FR 2531103 B1 19851122; DE 3368088 D1 19870115; EP 0102874 A1 19840314; EP 0102874 B1 19861203; JP S5943857 A 19840312; US 4486233 A 19841204

DOCDB simple family (application)

FR 8213431 A 19820730; DE 3368088 T 19830727; EP 83401550 A 19830727; JP 13792283 A 19830729; US 51843183 A 19830729